



Our Solutions, Your Value

any volume  
any mix



\*整体交换台车为选购件

NM-EJM8B

机种名

# BM series

型号: NM-EJM6B, NM-EJM7B, NM-EJM8B, NM-EJM1C

- 在小型机架上，继承了Panasonic的最先进技术，实现了优良的生产率和信赖性、经济性

### ⚠ 安全注意事项

● 使用前，请务必仔细阅读使用说明书，再正确使用。

● 为了安全使用目录中所记载的商品，在使用时，无论是在商品的运转时，还是停止时，都请仔细确认设备附属的使用说明书及设备的警告告示之后，再进行正确的操作。



Panasonic集团积极推进保护环境的产品生产工程。  
<http://panasonic.net/eco/>



在Panasonic集团的世界各工厂组建环境管理系统，取得国际规格ISO14001:2004认证。

咨询...

松下生产科技株式会社  
营业总括部

邮编 409-3895 日本国山梨县中臣摩郡昭和町纸漣阿原 1375番地  
电话 +81-055-275-9148  
传真 +81-055-275-6269

本目录的记载内容为2013年4月1日时的内容。

Ver.2013.4.1

©Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. 2013



\*会随选购件的构成或客户规格，而不适用于机器指令和EMC指令。

机种名	A型			
	BM123	BM133	BM221	BM231
型号	NM-EJM6B	NM-EJM7B	NM-EJM8B	NM-EJM1C
基板尺寸(mm)	L 50 x W 50 ~ L 330 x W 250	L 50 x W 50 ~ L 510 x W 460	L 50 x W 50 ~ L 330 x W 250	L 50 x W 50 ~ L 510 x W 460
贴装速度	0.12 s/芯片		0.25 s/芯片	
贴装精度	± 50 μm/芯片 (Cpk ≥ 1)、± 30 μm/QFP (Cpk ≥ 1)			
元件搭载数量	80 (双式编带料架:160)		60 (双式编带料架:120)、托盘:80	
元件尺寸(mm) <sup>*1</sup>	0402 <sup>†</sup> 芯片 ~ L 32 x W 32 x T 15		0402 <sup>†</sup> 芯片 ~ L 150 x W 25 x T 25 or L 55 x W 55 x T 25	
基板替换时间 <sup>*2</sup>	2.5 s <sup>*6</sup>	5.0 s	2.5 s (高速搬送规格时 <sup>*6</sup> )	5.0 s
电源	三相 AC 200、220、380、400、420、480 V 1.0 kVA			
空压源	0.43 MPa、150 L/min (A.N.R.)			
设备尺寸(mm)	W1950xD1500 <sup>*3</sup> x H1500 <sup>*4</sup>	W1950xD1710 <sup>*3</sup> x H1500 <sup>*4</sup>	W1950xD2060 <sup>*3</sup> x H1500 <sup>*4</sup>	W1950xD2270 <sup>*3</sup> x H1500 <sup>*4</sup>
重量 <sup>*5</sup>	1 700 kg(固定供给规格)	1 800 kg(固定供给规格)	2 000 kg(固定供给规格)	2 100 kg(固定供给规格)

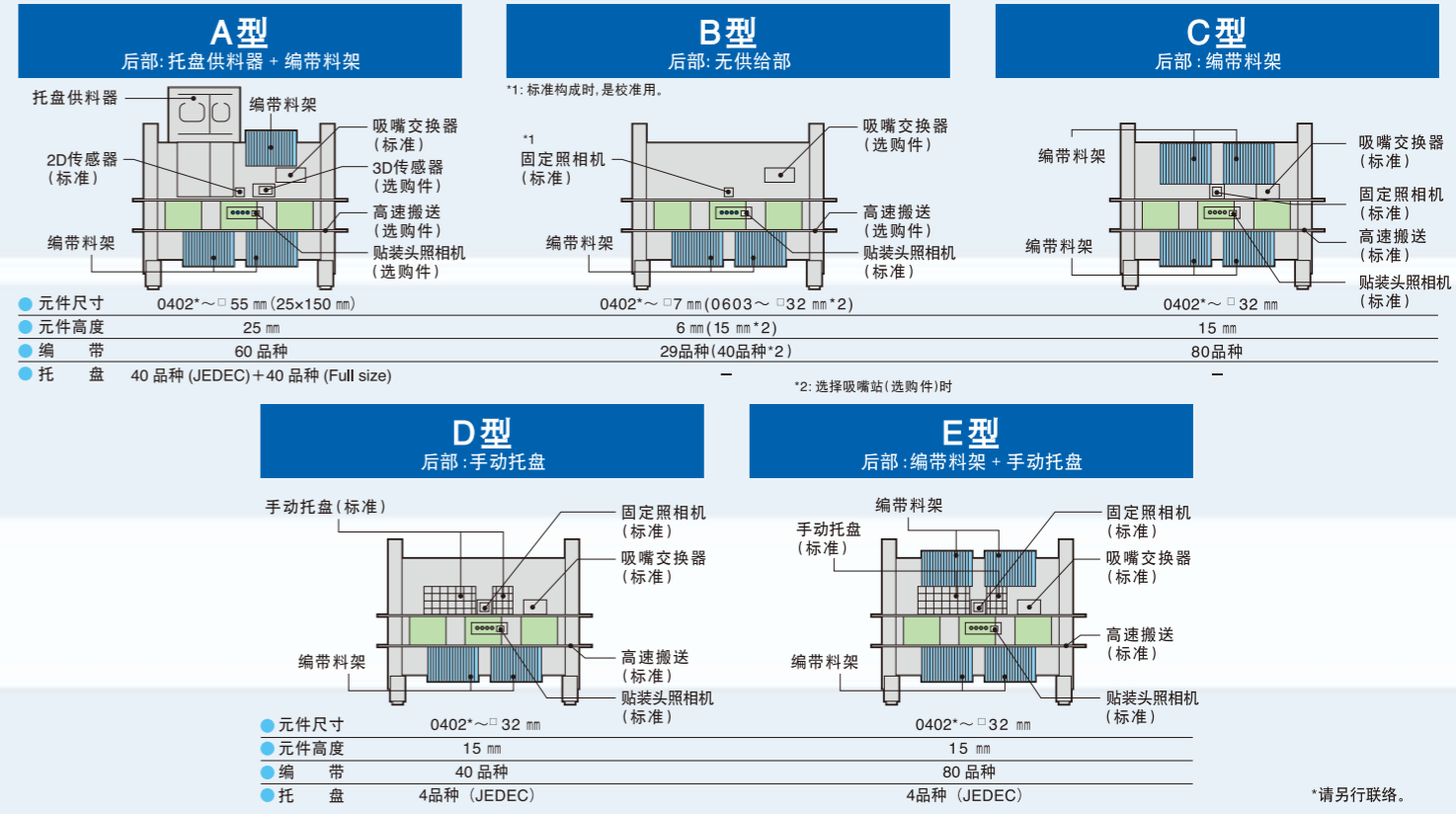
\*贴装速度及精度等值，会随条件而异。  
\*详细请参照《规格说明书》。

\*1:随选择规格而异  
\*2:因基板规格的不同而异。  
\*3:不包括整体交换台车、编带料架。  
\*4:不包括识别监控器、信号塔。

\*5:包括整体交换台车时。  
BM123:2100 kg BM221:2200 kg  
BM133:2200 kg BM231:2300 kg  
\*6:背面没有贴装元件时  
\*7:请另行联络。

后部供给部的  
丰富种类  
[BM221]

right-sized  
solutions  
for world-class  
manufacturing



广范围元件

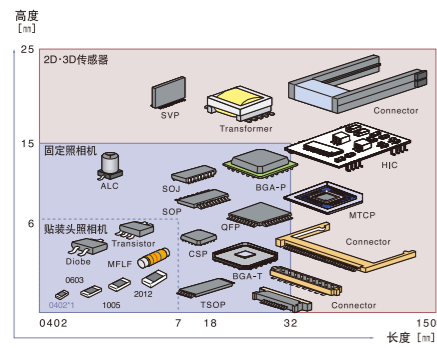
短时间  
机种切换

高速  
高精度贴装

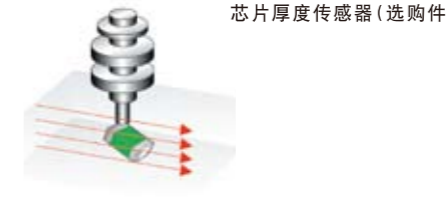
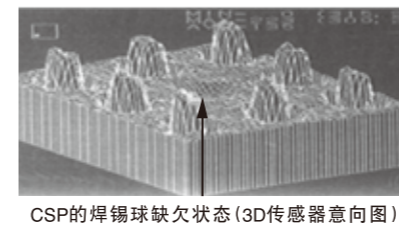
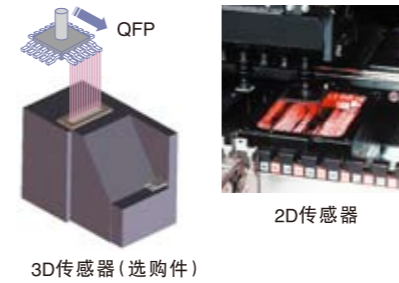
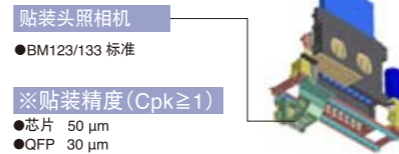
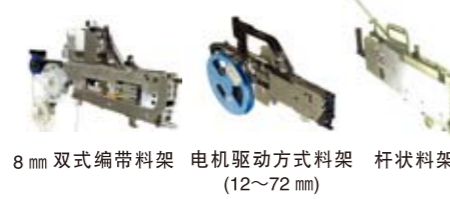
搭载3D传感器  
(选购件)

搭载芯片厚度传感器  
(选购件)

对应直接托盘



	贴装头照相机	固定照相机	2D传感器	3D传感器
BM123、133	标准	标准	—	—
BM221	A型	选购件	—	标准
	B、C、D、E型	标准	标准	—
BM231	选购件	—	标准	选购件



0402\*1芯片~L 55 mm × W 55 mm or  
L 150 mm × W 25 mm 的大型元件, 通过编带·  
托盘供给, 能够进行长时间连续运转。  
BM221、231能够最多配备120品种编带元件\*2,  
JEDEC标准时是80品种。

优良的机种切换性  
●整体交换台车  
●电机驱动方式料架  
●编带拼接(运转中的元件供给)  
●最佳化软件

通过8支吸嘴独立上下驱动, 能够进行高度  
不同元件的整体识别和整体吸着。

\*根据条件不同而异

通过2D、3D传感器, 能够进行从微小芯片至  
L 55 mm × W 55 mm × T 25 mm 的大型元件以及  
QFP、BGA、CSP的高精度贴装。

通过搭载芯片厚度传感器,  
能够检测微小元件微妙的竖起吸着,  
从而提高贴装品质。

通过双式托盘供料器能够进行QFP和异形  
元件的高速供给和连续供给。(BM221、231)  
另外, 也可选择手动托盘工作台。(BM221)

\*1: 请另行联络。  
\*2: 8mm双式编带料架时

\*请另行联络。